

中国电子电路行业协会

第39期

信息部

2024年1月12日

一、行业

中科院发布报告：预计 2024 年我国 GDP 增速为 5.3%左右

1月9日,中国科学院预测科学研究中心发布《2024 中国经济预测与展望》，对 2024 年中国经济增长、投资、消费、进出口、国内物价和国际大宗商品价格、粮食产量等方面的年度运行做出预测。报告指出，2024 年全年经济走势将呈现平稳运行，稳中有进、前低后高的态势，预计全年 GDP 增速为 5.3%左右。2024 年，我国经济内生动力平稳增长，投资增速较 2023 年加快。在就业形势趋好、居民消费意愿恢复向好、财政政策积极的情景下，预计 2024 年我国最终消费将稳步增长。经济整体将持续稳定恢复，我国国际收支将总体保持平稳态势。（新华社）

世界银行预测：2020-2024 年将成为全球经济 30 年来最疲弱的五年

1月4日，外交部发言人汪文斌表示，过去一年，中国经济顶住外部压力，持续回升向好，高质量发展扎实推进。

相关国际机构预测，2023 年中国全年经济增长 5.2%左右，增速在全球主要经济体当中保持领先，仍是全球增长的最大引擎。中国将继续成为拉动世界经济增长的重要引擎，为充满不确定性的全球经济带来确定性和正能量。（央视新闻）

美国 12 月 Markit 制造业 PMI 终值为 47.9，预期 48.4，前值 48.2

1 月 2 日，美国 12 月 Markit 制造业 PMI 终值为 47.9，预期 48.4，前值 48.2。美国 12 月 Markit 制造业 PMI 终值 47.9，创 2023 年 8 月份以来新低。产出分项指数终值 48.1，创 2023 年 6 月份以来新低、反转之前的扩张趋势。新订单分项指数终值也创 2023 年 8 月份以来新低。（财联社）

韩国 12 月芯片出口增长 21.8%，创 2022 年 3 月以来最大增幅

1 月 1 日，韩国 12 月芯片出口增长 21.8%，创 2022 年 3 月以来最大增幅。作为韩国经济增长的主要引擎，韩国出口在今年 10 月出现 13 个月以来的首次反弹。分析认为，出口改善可能会增强决策层的信心，认为韩国今年经济增长将符合他们的预期，而且如果需求保持住，明年经济可能会有更好表现。韩国央行官员表示：目前政策利率被认为足够严厉。

通货膨胀减缓的速度低于预期。出口预计改善，消费复苏逐渐开始。为了稳定房价，需要保持高利率。金融不平衡问题加剧。作为韩国经济的一大关键支柱，芯片行业也释放了积极信号（新华社）

二、市场

SIA：半导体销售额 2023 年 11 月同比增 5.3% 2024 年将实现两位数增长

1 月 10 日，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2023 年 11 月全球半导体行业销售额总计 480 亿美元，比 2022 年 11 月的 456 亿美元总额增长 5.3%，比 2023 年 10 月的 466 亿美元总额增长 2.9%。SIA CEO John Neuffer 表示：“2023 年 11 月份全球半导体销售额是自 2022 年 8 月以来首次同比增长，这表明全球芯片市场在进入新的一年之际继续走强，2024 年全球半导体市场预计实现两位数增长。”（SIA）

乘联会：2023 年新能源乘用车国内零售销量 773.6 万辆，同比增长 36.2%

1 月 9 日，乘联会公布了 2023 年 12 月份全国乘用车市场分析报告，2023 年 12 月新能源乘用车国内零售销量达到 94.5 万辆，同比增长 47.3%。12 月新能源乘用车生产达到 109.5 万辆，同比增长 45.4%，环比增长 10.5%。今年以来累

计生产 892.0 万辆，同比增长 33.7%。12 月新能源乘用车批发销量达到 110.8 万辆，同比增长 47.5%，环比增长 15.3%。今年以来累计批发 886.4 万辆，同比增长 36.3%。12 月新能源车市场零售 94.5 万辆，同比增长 47.3%，环比增长 12.1%。今年以来累计零售 773.6 万辆，同比增长 36.2%。12 月新能源车出口 10.2 万辆，同比增长 39.8%，环比增长 19.4%。今年以来累计出口 104.8 万辆，同比增长 72.0%。（乘联会）

SEMI 报告：2024 年全球半导体产能预计将达到创纪录的每月 3000 万片晶圆

1 月 2 日，SEMI 在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast 中宣布，全球半导体每月晶圆（WPM）产能在 2023 年增长 5.5% 至 2960 万片后，预计 2024 年将增长 6.4%，首次突破每月 3000 万片大关（以 200mm 当量计算）。2024 年的增长将由前沿逻辑和代工、包括生成式人工智能和高性能计算（HPC）在内的应用的产能增长以及芯片终端需求的复苏推动。由于半导体市场需求疲软以及由此产生的库存调整，2023 年产能扩张放缓。SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示：“全球市场需求的复苏和政府激励措施的增加，推动了关键芯片制造地区晶圆厂投资的激增，预计 2024 年全球半导体产能将增长 6.4%。全球对半导体制造业对国家 and 经济安全的战略重要性的高度关注是这些趋势的关键催

化剂。”《世界晶圆厂预测报告》显示，从2022年至2024年，全球半导体行业计划开始运营82个新的晶圆厂，其中包括2023年的11个项目和2024年的42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。（SEMI）

三、企业

三星电子去年营业利润同比下降84.92%

1月9日，韩国三星电子公司发布的初步数据显示，这家企业2023年营业利润为6.54万亿韩元（约合356亿元人民币），同比下降84.92%。去年销售额为258.16万亿韩元（1.4万亿元人民币），同比下滑14.58%。受半导体部门业绩不佳影响，三星电子全年营业利润时隔15年再次跌至10万亿韩元（544亿元人民币）以下。按季度看，公司去年四个季度营业利润呈现环比增长势头。其中，四季度营业利润达2.8万亿韩元（152亿元人民币），为全年最高，但同比下降35%。去年，随着芯片库存增加以及智能手机和笔记本电脑等终端需求走软，存储芯片价格大幅下滑。（韩联社）

特斯拉2023年交付181万辆

1月2日，特斯拉公布了2023年第四季度的汽车交付量。数据显示，该季度特斯拉汽车交付量为484,507辆，超过了市场预期的483,173辆。全年来看，特斯拉的车辆交付同比

增长了 38%，达到了 181 万辆。同时，其产量也同比增长了 35%，达到了 185 万辆，创下了历史新高。具体而言，Model 3/Y 是特斯拉 2023 年最主要的车型，在全部交付量中占据了大部分；其他车型包括 Model S/X 和少量 Cybertruck、Semi，共计交付 68,874 辆，总共交付 1,808,581 辆。然而，在很多市场中，特斯拉仍然被视为豪华品牌。在豪华电动车领域，特斯拉领先于其他品牌，并且领先地位无人能及。（第一财经）

台积电 3nm 获苹果以外订单，计划 2024 年底产能提升至 80%

1 月 3 日，最新的报告指出，2024 年台积电最尖端工艺将得到更广泛的采用，预计将在今年早些时候达到 80% 的产能，因为该公司除了苹果，还获得了更多的 3nm 订单。高通预计将在骁龙 8 Gen 4 SoC 中采用 N3E 工艺，而联发科计划将其用于其下一代天玑 9400 芯片。苹果将继续在 M3 Ultra 芯片和 iPhone 16 Pro 的 A18 Pro SoC 中使用台积电 3nm 工艺。还有 AMD 备受期待的 Zen 5 CPU、RDNA 4 GPU 和英伟达的 Blackwell 服务器 GPU。（经济观察网）

兴森科技：珠海 FCBGA 封装基板项目预计 2024 年第一季度进入小批量生产阶段，目前已有少量样品订单收入

1 月 10 日，兴森科技表示，公司珠海 FCBGA 封装基板项目部分大客户的技术评级、体系认证、可靠性验证均已通过，预计 2024 年第一季度进入小批量生产阶段，目前已有少量样品订单收入，金额较小。广州 FCBGA 封装基板项目设备安装调试已基本完成，已进入内部制程测试阶段。（格隆汇）

沪电股份：公司泰国子公司预期在 2024 年第四季度实现

量产

1 月 10 日，香港万得通讯社报道，沪电股份近期在接受调研时表示，由于海外客户更加关注并加强地缘供应链风险分散战略的实施，多区域分散风险运营能力或将逐步成为行业未来成长的关键，公司已购买位于泰国洛加纳大城工业园区内的面积约 201,846.8 平方米的土地，以满足公司泰国子公司未来项目建设需求。公司已加速泰国生产基地建设进程，基于公司战略合作和沪士泰国建设及营运资金的需要，公司与新士电子共同向公司泰国子公司增资 474,903 万泰铢，其中公司出资 470,153.97 万泰铢，新士电子出资 4,749.03 万泰铢。公司泰国子公司预期在 2024 年第四季度实现量产。（香

港万得通讯社报道)

托璞勒启动 IPO 辅导

近日，四川托璞勒科技股份有限公司（以下简称“托璞勒”）在四川证监局进行辅导备案，辅导机构为长江证券。

「托璞勒」团队 2009 年在上海诞生，2017 年经遂宁市政府招商引资，成立四川公司。「托璞勒」主要从事 CCL/PCB 整厂智能制造设备（5G）、VOC 废气环保设备的研发、制造，涉及 3C 电子、环保等行业。（36 氪）

珠海锐翔智能科技股份有限公司启动 IPO 辅导

1 月 3 日，珠海锐翔智能科技股份有限公司启动 IPO 辅导，辅导机构为国泰君安。珠海锐翔智能科技股份有限公司成立于 2006 年，是一家专业从事智能制造领域自动化设备开发的高科技企业，是行业内优秀的高精密自动化设备及智能化生产线整体解决方案提供商。（证券时报网）

特创科技启动 IPO 辅导，拟再闯关资本市场

1 月 5 日，特创科技昨日在广东证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为国泰君安。据辅导备案报告披露，2023 年 4 月 27 日，特创科技曾收到《关于终止对惠州市特创电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定》，因未能充分说明研发活

动内部控制制度的健全有效及研发投入的真实性，首次公开发行股票并上市申请被终止审查。业绩方面，特创科技2020~2022年分别实现营业收入7.51亿元、10.60亿元、11.52亿元，分别实现归母净利润2996.75万元、6158.52万元、8614.57万元。（财经新闻）

超颖电子拟沪市主板募资 10 亿元

1月5日，IPO新受理已开启，注册地在湖北的超颖电子电路股份有限公司（下称超颖电子）正是最新一批申请者。据悉，该公司2023年12月31日获得受理，由民生证券保荐，计划融资10亿元。其中，4亿元用于超颖电子电路股份有限公司高多层及HDI项目第二阶段，6亿元用于超颖电子电路股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款。超颖电子的间接控股股东系中国台湾上市公司定颖投控。超颖电子并无实际控制人。定颖投控各股东持股比例分散，一旦股东之间出现分歧，势必也将会给超颖电子带来困扰。（财经新闻）

普诺威 SIP 封装基板事业部一期产线成功通产,二期 m-SAP 新产线已于 2023 年 9 月连线投产

1月5日，据格隆汇报道，普诺威专注于BT载板产品的研发生产，在深耕MEMS类载板市场的基础上，依靠多年累积的客户资源和产品经验，完成传统封装基板向先进封装

基板的转型，投资 4 亿元新建了 m-SAP 制程生产线，主要聚焦于 RF 射频类封装基板、SIP 封装、电源模块管理、光通讯等细分领域市场。2022 年第四季度，SIP 封装基板事业部一期产线成功通产，二期 m-SAP 新产线已于 2023 年 9 月连线投产，目前产能正在爬坡中。针对 m-SAP 线的产品，普诺威正集中力量开发封装类半导体公司，目前已经完成华天科技、立讯精密等封装类的载板资格认证，并进入日月光半导体、诺思等供应商序列，其他客户正在同步开发中。（格隆汇）